

第5回

5G通信技術展

通信システム・部材、基地局設備などが出展

◆『第5回 5G 通信技術展』出展情報

この度東京ビッグサイトで開催される【第5回 5G 通信技術展】に弊社も出展させて頂くこととなりました。出展エリアは光通信技術エリアとなります。
この機会に是非当社ブースへお立ち寄り頂きますよう、お待ち申し上げます。

【会期】2022年6月29日（水）～7月1日（金）

10：00～18：00

※1日（金）のみ17：00終了

【会場】東京ビッグサイト（西ホール）

【URL】<https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/about.html>

【当社小間No.】小間番号 3-44

◆展示内容

①薄肉/深彫 MIM

*薄肉 MIM：プレス・切削で高難度の複雑形状



サンプル例

■サイズ

外形 28×15×8

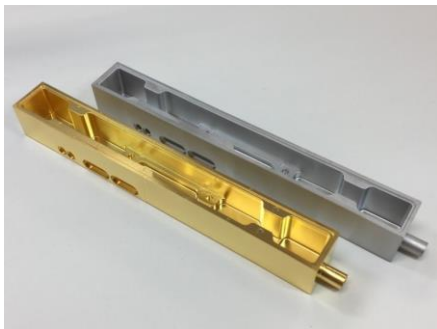
肉厚 底面部/フィン部：0.5 側面部：0.25

■材質/表面処理

純銅/Auメッキ

Kovar/Auメッキ

*深彫 MIM：薄肉パイプ部を一体化。切削工数、コスト削減、材料ロス低減を提案



サンプル例

■サイズ

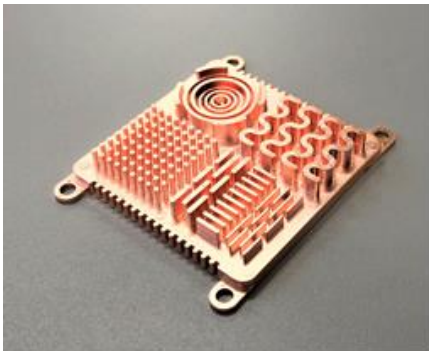
外形 120×15×15
肉厚 底面部：1.5~2.2 側面部：1.2~7.0

■材質/表面処理

SUS304L/Auメッキ
純銅/Auメッキ
純チタン/ホーニング

②純銅 MIM

*焼結技術により含有酸素量をコントロール、無酸素銅と同等の高熱伝導率を達成



サンプル例

■サイズ

外形 45×55
フィンサイズ（最小）：t0.4×h 2.0
フィン間ピッチ：1.0
ピンサイズ：Φ1.0×h4.0

③高密度 Ni フリーステンレス材<新技術>

*独自開発原料粉末を用いた Ni フリーステンレス材



■特長

- ① 高鏡面化：密度 99.5%以上を実現
焼結体表面のマイクロポアと介在物を低減
- ② Ni フリーステンレス
Ni アレルギーの方でも安心
- ③ 高耐傷性
高硬度（350Hv 程度）で表面にキズが付きにくい
- ④ 高耐食性
SUS316L (MIM 材) の 5 倍以上の耐食性
(孔食電位)

以上